

华虹半导体有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

网上路演公告

联席保荐人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

联席保荐人（联席主承销商）：海通证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司

联席主承销商：国开证券股份有限公司

华虹半导体有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行 40,775.0000 万股人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1228 号文同意注册。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）、海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）担任本次发行的联席保荐人（联席主承销商）（国泰君安和海通证券以下合称“联席保荐人（联席主承销商）”，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）、国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）担任本次发行的联席主承销商（国泰君安、海通

证券、中信证券、中金公司、东方投行和国开证券以下合称“联席主承销商”)。

发行人和联席主承销商将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标。

本次拟公开发行新股 40,775.0000 万股，占发行后发行人总股本的 23.76%。本次发行初始战略配售数量为 20,387.5000 万股，占本次发行数量的 50.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数量为 16,310.0000 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 80.00%，网上初始发行数量为 4,077.5000 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2023 年 7 月 24 日（T-1 日） 9:00-12:00

2、网上路演网址：上证路演中心：<http://roadshow.sseinfo.com>

上海证券报-中国证券网：<http://roadshow.cnstock.com>

3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。

本次发行的《华虹半导体有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：华虹半导体有限公司

联席保荐人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

联席保荐人（联席主承销商）：海通证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司

联席主承销商：国开证券股份有限公司

2023年7月21日

（此页无正文，为《华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》盖章页）



发行人：华虹半导体有限公司

2023年7月21日

（此页无正文，为《华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》盖章页）

联席保荐人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司



（此页无正文，为《华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》盖章页）

联席保荐人（联席主承销商）：海通证券股份有限公司



2023年7月21日

(此页无正文，为《华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》盖章页)

联席主承销商：中信证券股份有限公司



2023年7月21日

（此页无正文，为《华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司



2024年7月21日

（此页无正文，为《华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》盖章页）

联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司



2023年7月21日

（此页无正文，为《华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》盖章页）

联席主承销商：国开证券股份有限公司

